

國立臺北科技大學 函

地址：106344臺北市大安區忠孝東路三段
一號

承辦人：黃澤淵

電話：2771-2171#6023

電子信箱：receivable0308@ntut.edu.tw

受文者：國立嘉義大學

發文日期：中華民國115年9月1日

發文字號：北科大產學字第1157900262號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：課程表、海報 (115F900736_1_01092558291.pdf、115F900736_2_01092558291.png)

主旨：檢送本校與實威國際股份有限公司合作辦理115年「以
AI 輔助為核心之 SOLIDWORKS 半導體散熱設計與熱流分
析實務」課程資訊（詳如說明），敬邀貴校教師踴躍報名
參加，並請協助公告，請查照。

說明：

- 一、依據技術及職業教育法第二十六條第一項規定：「技職校
院專業科目或技術科目教師、專業及技術人員或專業及技
術教師，每任教滿六年應至與技職校院合作機構或與任教
領域有關之產業，進行至少半年以上與專業或技術有關之
研習或研究」，辦理教師深度實務研習課程。
- 二、隨著 AI 晶片與高效能運算（HPC）技術的快速發展，晶片
功耗與熱密度持續飆升，使得散熱挑戰已從單一元件擴展
至伺服器與資料中心等系統層級。目前半導體產業設備商
與 AI 伺服器供應商，大多採用 SOLIDWORKS 進行 3D 設
計。然而，傳統著重於機構結構與外型的 3D 教學，已無
法滿足半導體產業對工程人才的實際需求。新世代的設計



工程師，必須在研發初期就具備基本熱流分析與散熱驗證的關鍵能力。為了縮短產學落差並解決學校經費不足的痛點，實威國際今年特別推出產學合作計畫，致力於培育產業界所需的即戰力專才。我們讓學生在校園內，就能操作與半導體設備指標大廠同等級的頂級模擬分析工具，在學期間即掌握晶片散熱與熱流模擬的核心技術，藉此大幅提升未來進入半導體與 AI 供應鏈的就業競爭力。本活動特別針對有教學使用需求的老師進行實務培訓，為了給予校園最實質的支持，凡是全程參與課程、且後續有實際教學應用的老師，實威國際將於課後進行軟體捐贈，協助老師將業界最新的研發工具直接引進課堂，建構更具競爭力的特色課程。由於各項軟體捐贈套數與資源有限，本次活動的實體席次僅開放 30 人名額(線上50人)。歡迎所有對半導體設備、AI 伺服器設計與熱流模擬教學有興趣的大專院校老師踴躍報名參加，及早為校園爭取頂尖的教學資源。

三、報名資格：全國各大專校院及高中職教師。

四、課程時間：115年9月3日（四）共計1日，凡全程參與研習課程者，且符合報名資格者（全國各大專校院及高中職教師），將於課程結束後核發電子研習時數證明。

五、課程地點：國立臺北科技大學綜合科館電機系511教室（臺北市大安區忠孝東路三段1號）

六、課程人數上限：實體30人，線上50人。

七、報名時間：即日起至115年9月1日（一）17點為止（若人數額滿將提前截止）。

八、報名網址：<https://forms.gle/PaXSy7xV74y4bub59>

九、課程聯絡人：教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學黃專員，連絡電話：(02)2771-2171分機6023，電子郵件：receivable0308@mail.ntut.edu.tw、鄭經理，連絡電話：(02)2771-2171分機6012，電子郵件：clcheng@mail.ntut.edu.tw。陳專員，連絡電話：(02)2771-2171分機6020，電子郵件：avery00620@ntut.edu.tw

十、協辦單位：實威國際股份有限公司。

十一、檢附課程表及宣傳海報。

正本：各公私立大專校院

副本：本校產學合作處

